

2011年全球内存行业研究报告

2011年，由于标准型DRAM成长乏力，晶圆价格和出货量均下降。而平板电脑和智能手机的兴起，使得Mobile DRAM出货量的年复合增长速度达到175%，今年第一季度Mobile DRAM 已占到全球DRAM总产出的15.6%。

手机Flash的年复合增长率超过70%，内嵌式Flash市场占Flash市场的比重将由2010年的四成增长到六成以上。eMMC在移动设备领域大有前途。

根据各大DRAM厂内存产品在2011年上半年的营收排名，韩系厂商三星和海力士稳居前两位。

三星DRAM技术制程将由3x纳米进入到2x纳米，NAND Flash技术制程由27纳米进入21纳米。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及MCP的销售收入分别占三星内存总收入的54.4%、42.3%及3.3%。受惠于35纳米产出占比大幅上升，第二季度三星内存市场份额超过40%。在Mobile DRAM领域，三星已经量产30纳米制程的低功耗LPDDR2产品。



海力士公司DRAM技术制程将由44纳米进入到38纳米，NAND Flash技术制程由26纳米进入20纳米。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及MCP的销售收入分别占海力士内存总收入的71.2%、19.7%及9.1%。海力士目前以50nm制程生产Mobile DRAM，2011第二季开始将新增3万片的月产能，年底计划将非PC的DRAM的比重提高到60%。

日系厂商东芝与Sandisk公司共同投资NAND晶圆厂，当前采用19nm制程技术。尔必达2011年量产30纳米制程的DRAM产品。尔必达已将重心从标准型DRAM转向Mobile DRAM，并导入30纳米制程生产后者。Mobile DRAM营收已占尔必达DRAM营收50%以上。

美光科技现行制程技术为42纳米，37纳米处于样品测试阶段。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及NOR的销售收入分别占美光科技总收入的47%、31%及19%。Spansion公司于2010年重组后，专注于嵌入式内存领域，2011年Spansion和三星同意交叉授权彼此的专利产品。

台系厂商旺宏为全球最大的Mask ROM厂商及第四大NOR Flash 制造商。2011年第一季度，其ROM技术制程以65纳米为主，二季度45纳米将出样品。旺宏NOR Flash技术制程以110纳米为主，二季度75纳米产品将大批量生产。旺宏1Q11 ROM 营收比重占41%、NOR Flash 占51%、Foundry Business Group 占8%。

南亚科技2011年内存产量扩产到6万片，其中3万片为50/42nm标准型内存，另外3万片为特殊内存，包含Mobile DRAM 等产品。



代工厂商华亚科技提供 DRAM 内存晶圆代工服务，其客户为南亚科技与美光科技。2010年50纳米制程产品产能满载，2011年导入42纳米DRAM产品。

华邦科技2011 年主要成长动力为Nor Flash，其中Serial Nor Flash占其 Flash出货约9成。2011年第一季度，Nor Flash、利基型DRAM及Mobile DRAM分别占华邦科技总收入的 31%、36%及28%。其Mobile DRAM客户主要为 Micron 与Spansion。



报告目录

第一章、全球及中国手机市场

- 1.1、全球手机市场规模
- 1.2、手机厂家市场占有率
- 1.3、智能手机市场与产业
- 1.4、中国手机产业

第二章、全球及中国平板电脑市场与产业

- 2.1、全球平板电脑市场规模
- 2.2、中国平板电脑市场
 - 2.2.1、中国平板电脑价格分布
 - 2.2.2、中国平板电脑操作系统与硬件
- 2.3、平板电脑组装与ODM

第三章 内存产业及市场

- 3.1 内存行业概况
 - 3.1.1 内存产品和技术

3.1.2内存市场规模

3.1.3 DRAM封测

3.1.4 Flash封测

3.1.5 eMMC

3.2 DRAM市场

3.2.1 DRAM供给市场

3.2.2 DRAM需求市场

3.2.3 DRAM市场竞争格局

3.3 Flash市场现状

第四章 移动设备用内存行业

4.1 Mobile DRAM产品及应用

4.2 Mobile DRAM市场

4.2.1 Mobile DRAM市场规模

4.2.2 Mobile DRAM 应用市场

4.2.3 Mobile DRAM厂商投产情况

4.3 移动设备用Flash



第五章 内存厂商

5.1 三星

5.2 海力士

5.3 东芝

5.4 尔必达

5.5 美光科技

5.6 飞索半导体

5.7 旺宏电子

5.8 华亚科技

5.9 华邦

5.10 力晶

5.11 茂德

5.12 南亚科技



图表目录

- 2007-2014年全球手机出货量
- 2008年1季度-2011年1季度每季度全球手机出货量与年度增幅
- 2007-2011年每季度CDMA、WCDMA手机出货量
- 2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
- 2009-2010年全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
- 2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
- 2011年1季度全球主要智能手机厂家市场占有率
- 2009-2012年智能手机操作系统市场占有率
- 2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
- 2000-2010年中国手机出口量与增幅
- 2002-2010年中国手机出口额与增幅
- 2002-2010年中国手机出口量与ASP
- 2010年中国手机产量地域分布
- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量



- 2011-2012年全球主要品牌平板电脑出货量
- 2010-2011年主要内存厂商DRAM和NAND技术制程的发展
- 2003-2010年DRAM产品演进
- 2005-2015年内存市场规模及增长率
- 2005-2015年内存市场规模
- eMMC与普通NAND chip 比较
- 2002-2011年DRAM产业资本投资
- 2011年全球DRAM晶圆投入
- 2007-2012年DRAM晶圆厂数量
- 2000-2011年DRAM晶圆厂建设及关闭数量
- 主要DRAM厂商的季度运营利润率
- 2000-2012年DRAM出货量增速
- DRAM fab model
- DRAM bit shipment model
- DRAM revenue model
- DRMA应用容量（分应用领域）
- 2005-2015F PC出货量(分产品)
- 2010 年DRAM 报价及供需状况



- 2011年6月 DRAM合约价格
- 2010年6月-2011年6月DDR3 2Gb 现货报价
- 2006-2012年标准型内存平均搭载容量及增长率
- 2005-2012年DRAM市场规模及增长率
- 2005-2015年DRAM市场规模（分应用领域）
- DRAM厂商10Q3 及11Q2 营收及市场份额
- 2005-2012年NOR市场规模及增长率
- 全球NOR Flash 厂商市场份额及排名
- 1Q11-2Q11NAND Flash报价
- 2005-2012年NAND市场规模及增长率
- 2008-2015年NAND 应用单位出货量
- 2008-2015年NAND平均负载（分应用领域）
- 2008-2015年NAND市场需求（分应用领域）
- 2008-2012年NAND需求市场（分应用行业）
- 2004-2015 NAND Flash 投资支出
- 2000-2011年NAND晶圆厂建设及关闭数量
- NAND fab model
- NAND bit shipment model



- NAND 应用市场需求
- NAND ASP model
- 各内存厂商NAND 收入
- 2008-2011F全球Flash厂商市场份额
- NAND控制IC厂商一览
- 标准型DRAM、Mobile DRAM的比较
- DDR、DDR2与DDR3的比较
- Mobile DRAM 大多以MCP为主再与Chipset做堆叠
- Mobile DRAM在DRAM市场中所占比重
- 2010年典型高端智能手机规格
- 2006-2012年智能手机存储器平均搭载容量及增长率
- 2006-2012年平板电脑存储器平均搭载容量及增长率
- 主要DRAM厂商推出的Mobile DRAM产品
- 主要DRAM厂Mobile DRAM规格
- DRAM厂商Mobile DRAM市场份额
- 1Q09-4Q11全球Flash供需市场
- 2005-2012F 内嵌式Flash出货比例
- 2009-2014F手机用Flash出货量



- eMMC Share of Total Flash Market
- eMMC Density Trend
- Mobile Handset Booting Architecture
- 各NAND 大厂 eMMC 品牌
- 2008-2010 SAMSUNG Sales and Profits
- 2008-2010 SAMSUNG Sales by Division
- 2008-2010 SAMSUNG Operating Profit by Division
- 2010Q1-2011Q4 SAMSUNG Memory Segment Sales by product
- 2010Q1-2011Q4 SAMSUNG DRAM shipments and asp per quarterly
- 2010Q1-2011Q4 SAMSUNG NAND shipments and asp per quarterly
- 2011年SAMSUNG电子DRAM和NAND收入中苹果公司贡献情况
- SAMSUNG MCP技术路线
- SAMSUNG Mobile DRAM and MCP Product
- SAMSUNG eMMC Product
- 2007-2011年海力士营收及毛利率
- 2010Q1-2011Q4 HYNIX Memory Segment Sales by product
- 2010Q1-2011Q4 HYNIX DRAM shipments and asp per quarterly
- 2010Q1-2011Q4 HYNIX NAND shipments and asp per quarterly



- Q1/2010-Q1/2011 Hynix sales by application
- 2010Q1-2011Q4 HYNIX DRAM Sales by node
- 2010Q1-2011Q4 HYNIX NAND Sales by node
- HYNIX手机用MCP内存型号解码
- FY2004-FY2010年Toshiba 销售收入及净利润
- FY2010和FY2012东芝投资和研发支出
- FY2007-FY2010年Toshiba 存储产品销售收入
- NAND Flash Memory Product
- Toshiba eMMC Product
- FY2006-FY2010年尔必达营收及毛利率
- FY2004-FY2010年尔必达DRAM产品营收
- 尔必达2011财年资本支出
- FY2003-FY2010尔必达营收和净利润
- 2009-2010年尔必达营业收入（分地区）
- 尔必达业务架构
- 尔必达Mobile DDR/DDR2 DRAM Product
- FY2004-FY2011 MICRON Sale and gross margin
- FY2006-FY2010Micron 收入结构（分产品）



- FY2006-FY2010 Micron 收入结构 (分应用领域)
- Micron业务架构
- FY2011Q1-Q3 Micron 营业收入 (分业务)
- Q3/FY09-Q3/FY11 MICRON R&D and SG&A Expenses
- Q1/FY10-Q3/FY11 MICRON Cash Flow From Operations
- 2004-2010年Spansion收入与毛利率
- 2Q09-1Q11 Spansion收入与毛利率
- 2Q10-1Q11Spansion收入 (分应用行业)
- 2Q10-1Q11Spansion收入 (分地区)
- 2003-2011 Macronix sales and gross margin
- 06/2009-06/2011 Macronix sales per month
- Q1/2009-Q1/2011 Macronix gross margin
- Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Sales Breakdown by Products
- Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Quantity Breakdown by Products
- Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Sales Breakdown by Technology
- Q1/2006-Q1/2011 Macronix 8" Equivalent Wafer Out & Utilization Rate
- Q1/2006-Q1/2011 Macronix ROM quantity index
- Q1/2009-Q1/2011 Macronix ROM Shipments by technology



- Q1/2006-Q1/2011 Macronix NOR Flash quantity index
- Q1/2009-Q1/2011 Macronix NOR Flash Shipments by technology
- 2011Q1 Macronix NOR Flash breakdown
- 2004-2011年华亚科技收入及毛利率
- Q1/2010-Q1/2011 Inotera revenue and gross margin
- Q1/2010-Q1/2011 Inotera wafer shipments
- Q1/2010-Q1/2011 Inotera Quarterly Bit Shipments
- 2006-2010年Winbond 收入及毛利率
- 2Q09-1Q11年Winbond收入和毛利率
- 1Q09-1Q11年Winbond晶圆制程技术
- 2Q09-1Q11年Winbond营业收入结构（分产品）
- 1Q09-2Q11年华邦12吋晶圆产量（分产品）
- 1Q2011-1Q2012Winbond产品技术转移进程
- 2004-2010年Powerchip营业收入及毛利率
- 1Q2009-1Q2011年Powerchip营业收入及毛利率
- 1Q2011-4Q2011力晶DRAM和Flash研发进程
- 力晶DRAM产品参数
- 2004-2010年Promos 收入及毛利率

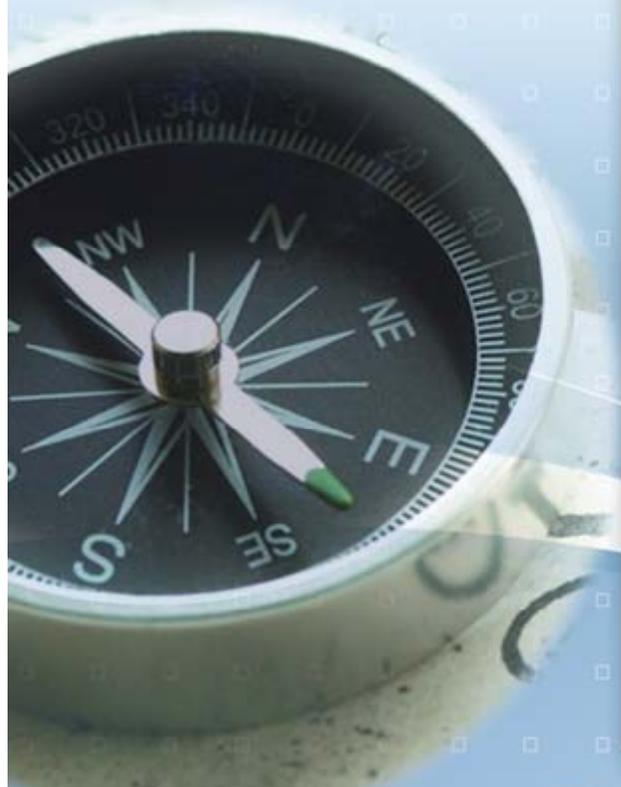


- 1Q2009-1Q2011年Promos 收入及毛利率
- Promos MCP Product
- 2004-2010年 Nanya 营业收入及毛利率
- 1Q2009-1Q2011年Nanya营业收入及毛利率
- 2008-2012F南亚科技DRAM 销量及收入
- 2003-2011年南亚科技资本支出
- 2010年美光科技、尔必达DRAM制程成本比较
- 制程技术提升至50nm时节省的成本



购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：135页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2011-08	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201108/24511348.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

